

Inhalt

		Seite
<i>P. Marquardt</i>	Der SIMIT-Effekt und die Grenzen der Mikroelektronik	1
<i>K. Fitzner</i>	Partikelbewegungen in Renräumen mit laminarer und turbulenter Strömung	23
<i>T. Rakoczy</i>	Gestaltung von Reinraumdecken mit Luftstrahlen	39
<i>E. Mayer</i>	Einfluß der Einströmrichtung auf die thermische Behaglichkeit in Renräumen	51
<i>G. Roos</i>	Der „Arbeitsplatz Reinraum“ aus arbeitsmedizinischer Sicht	59
<i>R. Sigusch und O. Selig</i>	Statische Aufladungen im Reinraum	77
<i>W. Kraft</i>	Ionische Kontamination — Einflüsse auf das Halbleiterprodukt	91
<i>W. Labuda</i>	Ionische und Partikel-Kontamination durch das Verbrauchsmaterial	101
<i>H. Eidam</i>	Konzept eines flexiblen Reinraumes	115
<i>R. von Dungen</i>	Automatisierung im Reinraum	123
<i>H.-J. Lippold und F. Reichert</i>	Hochleistungs-Schwebstofffilter für die Reinraumtechnik	135
<i>H. Fißan und S. Opiolka</i>	Korrelation zwischen Gas- und Oberflächenreinheit	195
<i>H. Palla</i>	Abbildung und Identifizierung von Polymerpartikeln mit Licht- und Elektronenmikroskopen	211
<i>U. Rohrer und H. H. Steinbeck</i>	Defektdichte und Oberflächenkontamination im μm Bereich in der Halbleiterspeicherproduktion	225
<i>V. Kreuter und G. Wenz</i>	Reinheitsanforderungen in einer Pilot-Linie zur Herstellung höchstintegrierter Schaltkreise	229
<i>R. Preisser</i>	Chemische Versorgung einer modernen Halbleiter-Produktionslinie	235
	Autorenverzeichnis	241